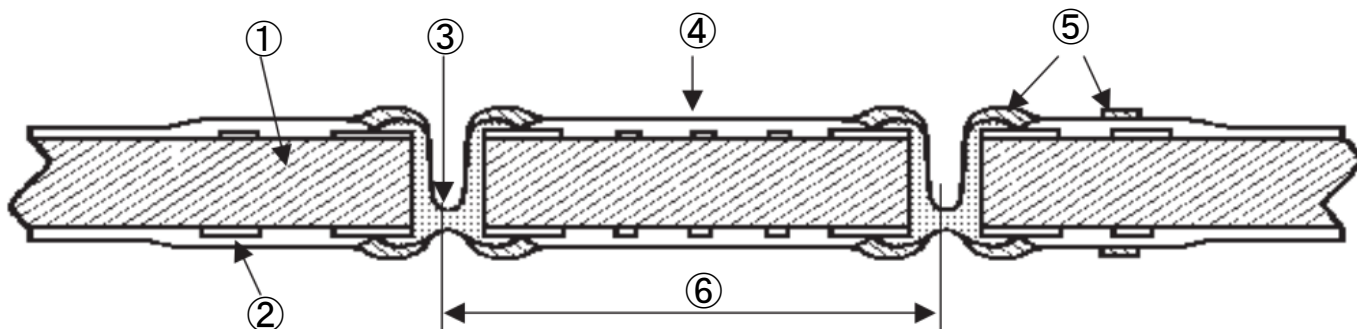


■特点

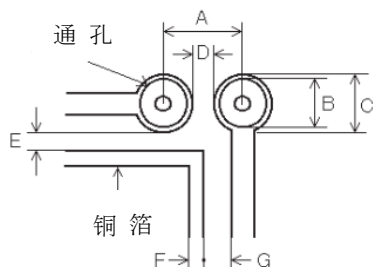
- 通过将镀铜通孔基板改为导热膏通孔基板，可实现显著的 VA 效果。
- 可轻松实现高密度电路制造。
- 可实现双面安装电路板。
- 采用导热膏通孔技术，可使用纸质酚醛树脂基板，确保可靠性。

■构造



名称	番号	名称
基材	④	阻焊剂
铜箔	⑤	标示兼通孔盖涂层
通孔	⑥	通孔间距

■设计标准



(mm)

通孔间距 A	C	D	E	F	G
1.00	0.80	0.20	0.25	0.20	0.20
1.25	1.00	0.25	0.25	0.20	0.20
1.50	1.20	0.30	0.30	0.20	0.20
1.75	1.40	0.35	0.40	0.20	0.20
2.00	1.50	0.50	0.50	0.20	0.20
2.50	2.00	0.50	0.50	0.20	0.20

■产品规格

项目	仕様		条件
	AgTh	CuTh	
基板材质	FR-1,C EM-3		
通孔	导电树脂		关于铜导热膏通孔，间距应为1.25毫米以上。
	银导热膏	铜导热膏	
使用温度范围	-30~+100°C		
通孔电阻值	100mΩ/hole	100mΩ/hole	
额定电流	300mA/hole	300mA/hole	1.25mm间距以下为250mA/孔
最高使用电压(異電位間電圧)	50V ※(20V)	100V	※适用于1.25毫米及以下间距
负荷寿命	200mΩ/hole	200mΩ/hole	70°C 1000Hr
耐湿负荷寿命	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40°C 90~95%RH 1000Hr
高温放置	200mΩ/hole	200mΩ/hole	100°C 1000Hr
耐湿放置	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40°C 90~95%RH 1000Hr
焊锡耐热	200mΩ/hole	200mΩ/hole	260°C 5 sec
回焊流耐热性	200mΩ/hole	200mΩ/hole	240°C 3 sec
银迁移	200mΩ/hole	200mΩ/hole	40°C 90~95%RH 1000Hr
热油	200mΩ/hole	200mΩ/hole	260°C 10sec 100 Cycle
热循环	200mΩ/hole	200mΩ/hole	-40°C ⇄ 100 30min 100 Cycle

■特性值 (参考值)

- Ag Th: 导热膏 (1.5mm 间距 FR-1 t=1.6mm)
- Cu Th: 导热膏 (1.5mm 间距 FR-1 t=1.6mm)

